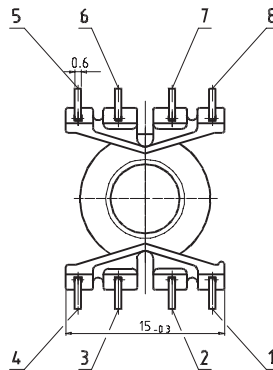
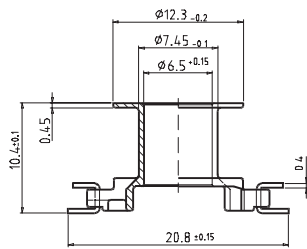




RM 6 SPULENKÖRPER: BOBBIN RM 6 - SMD



Stiftraster
pin pitch
 2,54 mm

freie Stiftlänge
free pinlength

Stiftart
type
 vierkant / squared

V-förmiger Mitnehmerschlitz im Oberflansch, Lötbarkeit 500° C

V-slot in the top flange, solderability 932° F

Wickelangaben / Winding data:

Kammern <u>sections</u>	Wickelquerschnitt in mm ² <u>winding area in mm²</u>	Mittlere Windungslänge (mm) <u>average length of turn (mm)</u>	Gewicht ca. <u>approx. weight</u>
1	15	30	0,57 g

Lieferbare Typen / Available Versions:

Anzahl der Stifte <u>number of pins</u>	Bestückte Positionen <u>terminals in use</u>	Anzahl der Kammern <u>number of sections</u>	Bestell-Code <u>Ordering-Code</u>
8	1,2,3,4,5,6,7,8	1	RM6E/8/1SMD



RM 6 SPULENKÖRPER: BOBBIN RM 6 - SMD

Material:	Hochtemperaturbeständiger Duroplast (Phenolharzformmasse) verstärkt mit Glasfaser, gelistet nach UL 94 VO, dauerstabil bis 180° C (Klasse H nach IEC 85).
Stifte:	Vierkantstifte aus CuSn, galvanisch beschichtet mit Sn, lötbar nach DIN IEC 68, Teil 2-20, Punkt 4, Prüfung Ta, Methode 1, Alterung 3.
Lötung:	Maximal 400° C bei < 2 sek.; Abstand zum Lötbad mindestens 0,5 mm.
Mechanische Werte:	Der Spulenkörper ist formstabil und biegefest durch gezielte Materialverstärkungen.

<i>Material:</i>	<i>High temperature resistant thermosetting material (phenolformaldehyde) acc. to UL 94 VO, glassfibre reinforced, for continuous temperature up to 362° F (class H acc. to IEC 85)</i>
<i>Pins:</i>	<i>Square shaped pins made of CuSn, with galvanic tin plating (Sn), solderable acc. to DIN IEC 68, part 2 to 20, para.4, test Ta, method 1, curing 3.</i>
<i>Soldering:</i>	<i>Max. 752° F for < 2 sec.; distance to solderbath min. 0,5 mm / 0,02 inch.</i>
<i>Mechanical data:</i>	<i>Detailed design modifications result in flexural strength and dimensional stability.</i>